

杭州晶华微电子股份有限公司  
投资者关系活动记录表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                |
| 参与单位名称        | 维金资本、长城证券、华福证券、华金证券、钰航投资、<br>泮沃资本、燕园投资、国元证券、第一创业证券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 时间            | 2025 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 线下会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书：纪臻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、介绍环节</p> <p>简单介绍公司发展历程和业务情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q1：请介绍一下公司 2025 年前三季度业绩情况。</p> <p>答：2025 年前三季度，虽受关税政策扰动，公司智能健康衡器芯片、数字万用表芯片和智能家电控制芯片的市场需求受到部分抑制，但公司迅速调整市场策略，全力以赴，公司实现营业收入 12,316.97 万元，同比增长 27.32%。其中，2025 年第三季度公司实现营业收入 4,454.72 万元，同比增长 21.80%，较 2025 年第二季度环比增长 7.13%，本年度单季度销售业绩持续改善。</p> <p>2025 年前三季度，公司主营业务中，医疗健康 SoC 芯片产品收入占比为 33.97%，其中公司带 HCT 功能的血糖仪专用</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>芯片已向国内知名头部客户完成批量交付，人体健康参数测量（血糖血压血氧等）芯片销售收入同比增长 158.35%；工业控制及仪表芯片产品收入占比为 41.84%，其中由于公司大力推广新一代变送器单芯片解决方案和 4-20mA 电流环 DAC 芯片解决方案，公司工业控制芯片收入同比增长达 24.21%；智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 23.67%，主要系晶华智芯智能家电控制芯片的业务增量；电池管理芯片产品因处于推广初期，尚未实现规模放量销售，收入占比小。</p> <p>Q2：公司研发投入的情况？</p> <p>答：公司持续深化高性能模拟及数模混合集成电路领域的技术创新，围绕医疗健康、工业控制、智能家电及电池管理四大核心领域，加速推进新产品研发与量产进程。2025 年前三季度，公司研发费用 6,617.21 万元，同比增长 31.84%，公司在研芯片项目数量较去年同期增长 20.59%，流片次数提升 100.00%。</p> <p>Q3：如何看待芯片国产替代及公司产品国产替代的情况。</p> <p>答：近年来的外部环境变化，为芯片国产替代创造了重要的发展机遇。不同的产品应用，国产替代进程并不一样。公司在工业控制芯片领域深耕 20 年，2008 年已成功攻克工控 HART 调制解调器芯片的国产化替代设计，并实现规模出货。2013 年成功研发基于环路供电的 16-bit 高精度 4~20mA 电流 DAC 芯片 SD2421，可兼容替代亚德诺（ADI）的 AD421 系列芯片，并于 2021 年推出第二代 4~20mA 电流环 DAC 芯片 SD24A421，精度、温漂等参数指标接近国外同类竞品。近年来公司积极把握市场机遇，重点布局并推进医疗健康芯片、工控仪表芯片、智能家居芯片和 BMS 芯片等核心产品的技术突破和市场应用，并将结合自身技术积累和产品优势，推出符合市场发展方向的创新产品。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>Q4：公司毛利率的情况？</b></p> <p>答：公司主营业务毛利率为 50.99%，其中晶华微主营业务毛利率 57.04%，晶华智芯主营业务毛利率 33.04%。</p> <p><b>Q5：是否会继续关注并购机会？</b></p> <p>答：本年度，公司将围绕“精管协同”原则，系统推进与晶华智芯的整合管理。同时，公司将充分发挥上市公司平台作用，在夯实内生业务发展的同时，以主营业务为中心，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞争力。</p> <p><b>Q6：在 AI 人工智能、机器人等领域，公司是否有相关布局？</b></p> <p>答：公司产品下游应用领域众多，对新形势下带来的产业发展机会，公司会积极关注并谨慎评估业务机会，并持续加大研发创新。目前公司产品暂未应用到上述领域。</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 日期   | 2025 年 11 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |